



**桂林电子科技大学**  
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

## 硕 士 学 位 论 文

题目 基于嵌入式散热模块的微流道散热技术及传热特性研究

(英文) Research on microfluidic heat dissipation technology and

heat transfer characteristics based on embedded heat

dissipation module

研 究 生 学 号: 2020XXXXX

研 究 生 姓 名: 焱铭

指导老师姓名、职称: Spring Water 教授

申 请 学 位 门 类: 工学硕士

学 科、专 业: 机械工程

论 文 答 辩 日 期: 2023 年 5 月 6 日

## 独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得桂林电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：

日期：

## 关于论文使用授权的说明

本人完全了解桂林电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属桂林电子科技大学。本人保证毕业离校后，结合学位论文研究成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位仍然为桂林电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后遵守此规定）

作者签名：

日期：

导师签名：

日期：

## 摘 要

实体的三维测量与 CAD 模型的重构是目前国内外反求工程研究中的焦点问题。本课题对基于浮力测量的三维实体非接触测量装置及其重构算法的研究，具有重要的理论意义与广阔的应用前景。本文主要对课题中浮力测量涉及的部分关键技术进行了研究，并对装置机械结构进行了有限元分析。……

**关键词：**三维测量；浮力；重构算法；有限元分析

## ABSTRACT

3-D entity measurement and reconstruction of CAD model are key problems of reverse engineering research. The study of the buoyancy-based 3-D non-contact entity measurement device and reconstruction algorithm has theoretical significance and bright application prospect. The paper focuses on the research of some key technologies in buoyancy measurement and finite element analysis of the device mechanical structure.

**Keywords:** 3-D measurement; buoyancy; reconstruction algorithm; finite element analysis

## 插图索引

图 1-1 半导体芯片上的晶体管数量 .....	1
--------------------------	---

## 插表索引

表 4-1 计算 $2m \times 2m$ 理想导体平板时域感应电流采用的三种存储方式的存储 量比较。 .....	5
--	---

符号说明

$T_f$       流体温度 (K)  
 $T_s$       固体温度 (K)

希腊字符

$\mu_f$       流体动力粘度 ( $kg/(m \cdot s)$ )  
 $\rho_f$       流体密度 ( $kg/m^3$ )

下标

$f$       流体  
 $s$       固体

缩略语

PCB      Printed Circuit Board  
LTCC      Low temperature cofired ceramic  
MATD      mean absolute temperature deviation

## 目 录

摘 要 .....	I
ABSTRACT .....	II
插图索引 .....	III
插表索引 .....	IV
符号说明 .....	V
第一章 绪 论 .....	1
§1.1 课题的研究背景与意义 .....	1
§1.1.1 三维测量与重构技术研究现状 .....	1
第二章 多级嵌入式散热装置结构设计 .....	3
§2.1 多级嵌入式散热装置结构设计要求与思路 .....	3
§2.1.1 多级嵌入式散热装置研究对象 .....	3
§2.2 本章小节 .....	3
第三章 多级嵌入式散热装置单元级性能分析及优化 .....	4
§3.1 多级嵌入式散热装置单元级结构设计 .....	4
§3.2 本章小节 .....	4
第四章 多级嵌入式散热装置系统级性能分析及优化 .....	5
第五章 多级嵌入式散热装置实验研究 .....	6
第六章 全文总结与展望 .....	7
§6.1 全文总结 .....	7
§6.2 后续工作展望 .....	7
参考文献 .....	8
致 谢 .....	9
攻读硕士学位期间取得的成果 .....	10



# 第一章 绪 论

## §1.1 课题的研究背景与意义

### 微电子器件整体发展趋势

与传统的二维图像信息相比，物体的三维信息能够更全面、真实的反映客观物体，为人们提供更多的信息量。通过三维测量得到物体空间坐标信息，并对这些数据进行分析处理后，其结果可以广泛应用于计算机辅助设计与制造 (CAD/CAM)、反求工程 (RE)、快速原型 (RP) 及虚拟现实 (VR) 等领域，具有较高的实用价值 [1]。其中，三维信息的测量技术是基础，数据处理技术是核心，特征提取技术是关键，3 个部分既相互补充又相互促进。

### §1.1.1 三维测量与重构技术研究现状

实体的三维测量与 CAD 模型的重构是反求工程的两个主要阶段，本节重点总结了与课题相关的基于层析数据的三维测量与实体重构技术的国内外研究现状。一、三维实体测量技术

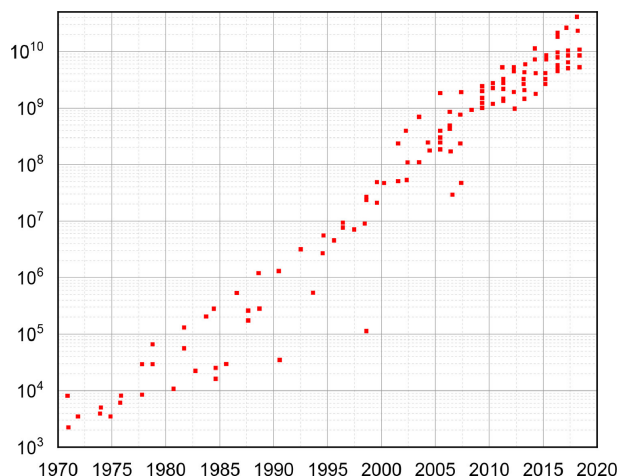


图 1-1 半导体芯片上的晶体管数量

$$MTF = \frac{1}{A J^2} \exp - \frac{\varphi}{K_B T} \quad (1-1)$$

本论文以时域积分方程时间步进算法的数值实现技术、后时稳定性问题以及两层平面波加速算法为重点研究内容，主要创新点与贡献如下：

**算法 1-1** How to write an algorithm.

**Data:** this text

**Result:** how to write algorithm with L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X2<sub>ε</sub>

```
1 initialization;
2 while not at end of this document do
3   read current;
4   if understand then
5     go to next section;
6     current section becomes this one;
7   else
8     go back to the beginning of current section;
9   end
10 end
```

## 第二章 多级嵌入式散热装置结构设计

### §2.1 多级嵌入式散热装置结构设计要求与思路

#### §2.1.1 多级嵌入式散热装置研究对象

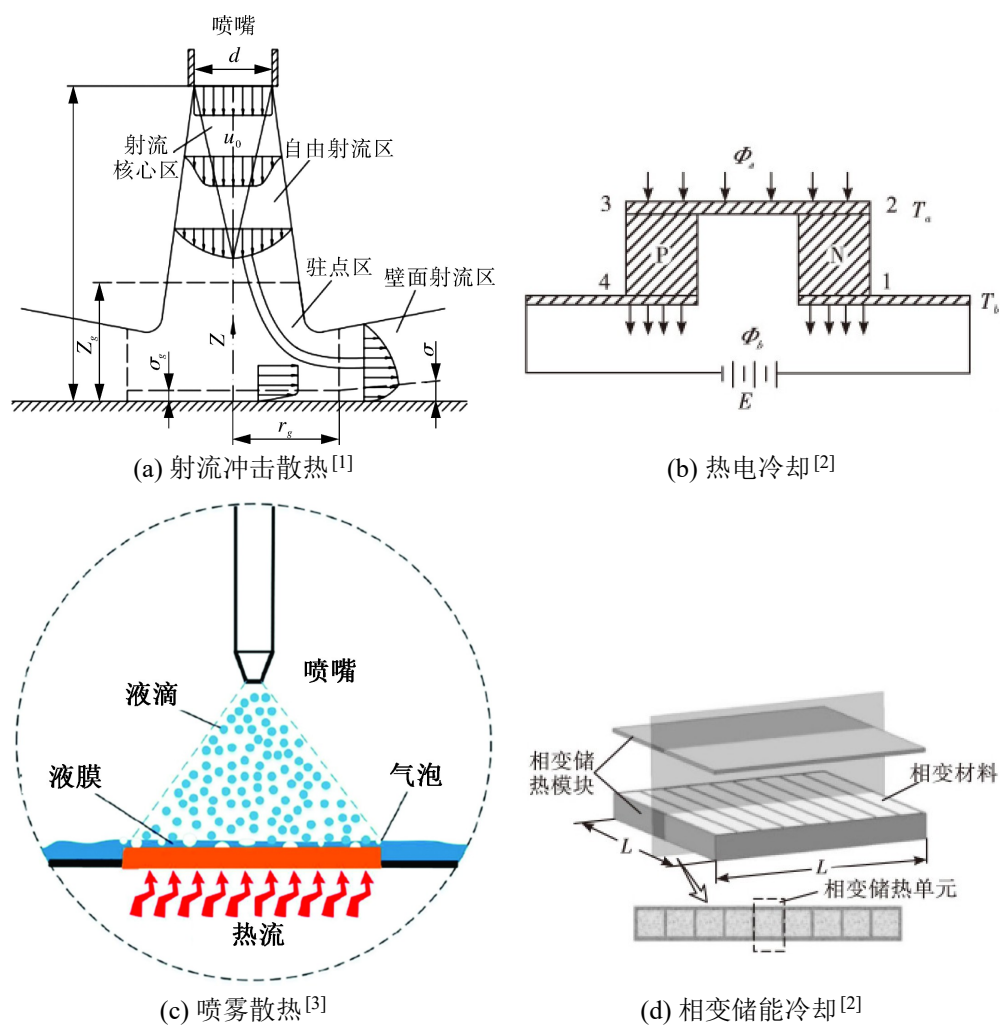
##### 1. 速度分布特征

接下来是内容

### §2.2 本章小节

## 第三章 多级嵌入式散热装置单元级性能分析及优化

### §3.1 多级嵌入式散热装置单元级结构设计



### §3.2 本章小节

## 第四章 多级嵌入式散热装置系统级性能分析及优化

表 4-1 计算  $2m \times 2m$  理想导体平板时域感应电流采用的三种存储方式的存储量比较。

时间步长	存储方式		
	非压缩存储方式	完全压缩存储方式	基权函数压缩存储方式
0.4ns	5.59 MB	6.78 MB	6.78 MB
0.5ns	10.17 MB	5.58 MB	5.58 MB
0.6ns	8.38MB	4.98 MB	4.98 MB

**定理 4.1** 如果时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合。

**证明:** 由于时域混合场积分方程是时域电场积分方程与时域磁场积分方程的线性组合, 因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。□

**推论 4.2** 时域积分方程方法的研究近几年发展迅速, 在本文研究工作的基础上, 仍有以下方向值得进一步研究。

**引理 4.3** 因此时域混合场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征与时域电场积分方程时间步进算法的阻抗矩阵特征相同。

## 第五章 多级嵌入式散热装置实验研究

## 第六章 全文总结与展望

### §6.1 全文总结

### §6.2 后续工作展望

## 参考文献

- [1] 吕静, 黄伶俐, 刘洪芝, 等. 冲击射流冷却高功率电子元件的试验研究[J]. 流体机械, 2021, 49(6): 1-8.
- [2] 段斐帆, 涂淑平. 电子设备散热的新技术[J]. 工业加热, 2021, 50(11): 63-68.
- [3] 齐文亮, 赵亮, 王婉人, 等. 高热流密度电子设备液冷技术研究进展[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(11): 4261-4270.



## 致 谢

在攻读硕士学位期间，首先衷心感谢我的导师 XXX 教授

## 攻读硕士学位期间取得的成果

### 一、参与的项目：

- [1] XXX 散热装置制造技术, XXX 部预研项目, 2022-2025, 在研。
- [2] XXX 焊接理论技术研究, XXX 部预研项目, 2020-2021, 已结题。
- [3] XXX 传热机理及散热技术研究, XXX 部预研项目, 2019-2020, 已结题。

### 二、发表论文：

- [1] XXX, XXX, et al. **Hydrothermal performance analysis of microchannel heat sink with embedded module with ribs and pin-fins[J]. Applied Thermal Engineering, 2023, 225: 120167.**  
(TOP 期刊, 中科院一区, IF: 6.465, 共同一作)

### 三、发明专利：

- [1] XXX, XXX, XXX 等. 一种基于 Fluent 的批量自动化仿真方法: 中国, CN114968537A [P]. 2022.

### 四、软件著作权：

- [1] XXX, XXX. 基于 Fluent 的磁性纳米流体微通道散热仿真自动化软件 [CP]. 中国广西桂林: 桂林电子科技大学, 2022.

### 五、科研竞赛获奖：

- [1] 第十五届全国数字工业设计大赛广西赛区二等奖（排名第二）